

2025年4月23日

日清エンジニアリング「第10回 高機能セラミックス展」に出展 ～当社独自の粉体技術で作製する高機能粒子を紹介～

日清製粉グループの日清エンジニアリング株式会社（取締役社長：後藤 卓弘）は、2025年5月14日（水）～5月16日（金）の3日間、インテックス大阪（大阪府大阪市）で開催される「第10回 高機能セラミックス展」に出展し、モノづくりに携わる多くの皆様に向けて当社がこれまで培ってきた粉体ハンドリング技術及びその技術を生かして作製した高機能粒子を紹介します。

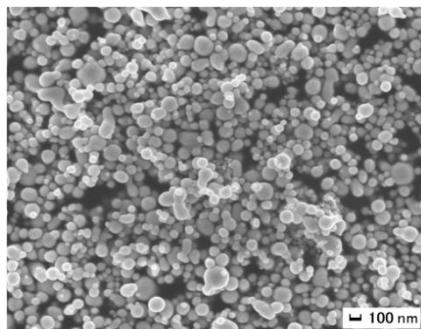
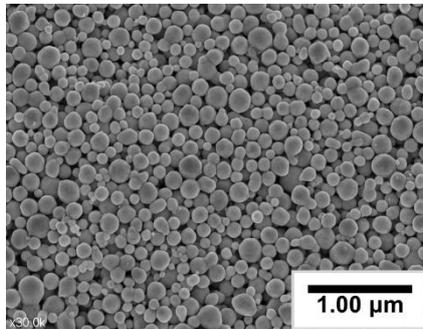
■ 出展ブース（小間番号：4号館 20-9）

当社は、「粉碎」「分級」「供給」によるブレイクダウン法と「高周波熱プラズマ」を用いたビルドアップ法を用いて、ナノサイズから数百ミクロンまでの粒子を作製した数多くの実績を保有しています。これらの粒子は、自動車や半導体等の電子材料や電池材料、磁性材料などに幅広く利用されており、近年は「微細化」「緻密化」「均一化・安定化」へのニーズがますます高まってきています。当社は独自の技術や確かな品質でお客様のモノづくりをサポートします。

ブースでは、パネル展示や動画を通じて、当社の様々な高機能粒子や粉体装置、粉体加工実績を紹介します。乾式における100nm以下の領域での分級を実現する旋回式分級機「エアロファインクラシファイア」、シングルミクロンまで効率良く粉碎し、サブミクロン粒子の解砕・分散も可能な気流式粉碎機「スーパージェットミル」、「高周波熱プラズマ法」で製造したセラミックスや金属、窒化物、炭化物を中心とした無機材料粉末のナノ粒子化、原料粉末の球状化処理を展示します。

<参考URL>

私たちの強み／進化する粉体技術について <https://www.nisshineng.co.jp/point/powder.html>



▲エアロファインクラシファイア

▲金属粉 サブミクロン粒子

▲銅ナノ粒子

■「第10回 高機能セラミックス展」概要

- ・開催期間：2025年5月14日（水）～5月16日（金）
- ・開催時間：10：00～17：00
- ・会場：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）
- ・主催：RX Japan株式会社
- ・共催：日本ファインセラミックス協会
- ・Webサイト：<https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/cera.html>

以上

この件に関する報道関係者のお問い合わせ先
株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 担当：清水
電話：03-5282-6650（お問い合わせフォームは[こちら](#)）